



Kongressprogramm



microsys berlin
Mikrooptik und Mikrooptische Systeme

Dienstag, 20. März 2012

SESSION 1: OPENING SESSION

9.00-9.20	1.1 Grußwort und Eröffnung N. Zimmer, Staatssekretär für Wirtschaft, Technologie und Forschung, Berlin
9.20-9.40	1.2 Hochentwickelte Integrationstechnologien für Intelligente Systeme K.-D. Lang, Chairman Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin
9.40-10.10	1.3 Key Note: Technique and equipment trends in high accurate device assemblies (in deutscher Sprache) G. Kürbis, FINETECH GmbH & Co. KG, Berlin
10.10-10.40	1.4 Key Note: Mikrointegrierte Diodenlaser-Systeme für Displays, Kommunikation und Spektroskopie G. Tränkle, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin
10.40-11.10	Kaffeepause

SESSION 2: PHOTONIC COMPONENTS I – DIODE LASERS

Moderation: G. Erbert; Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin

11.10-11.20	Einführung G. Erbert, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin
11.20-11.40	2.1 Towards high optical power nitride laser emitters (in englischer Sprache) P. Perlin, S. Stańczyk, Institute of High Pressure Physics, Warsaw P. Wisniewski, M. Leszczynski, TopGaN Ltd., Warsaw M. Zajac, Ammono Ltd., Warsaw
11.40-12.00	2.2 Tapered diode laser modules for flying-spot display applications (in englischer Sprache) G. Blume, D. Feise, C. Kaspari, A. Sahn, B. Eppich and K. Paschke, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin C. Kaspari, LayTec AG, Berlin
12.00-12.20	2.3 Kompakte, maßgeschneiderte ns-Lichtimpulsquellen im Butterfly-Gehäuse mit integrierter Ansteuerelektronik A. Klehr, Th. Hoffmann, A. Liero, S. Schwertfeger, H. Wenzel, G. Erbert, G. Tränkle, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin
12.20-12.40	2.4 AlxGa1-xN, das Materialsystem für maßgeschneiderte Photodetektoren von UVA bis UVC A. Knigge, M. Brendel, F. Brunner, S. Einfeldt, A. Knauer, M. Weyers, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin
12.40-13.00	2.5 Miniaturized, current-tunable, external cavity diode laser with single-mode emission and a narrow line-width at 633 nm (in englischer Sprache) A. Bawamia, B. Sumpf, G. Blume, B. Eppich, A. Ginolas, S. Spießberger, M. Thomas, G. Erbert, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin
13.00-13.30	Kaffeepause



SESSION 3: PHOTONIC COMPONENTS II – APPLICATIONS SILICON PHOTONICS (JOINT SESSION WITH ITG-PKM)

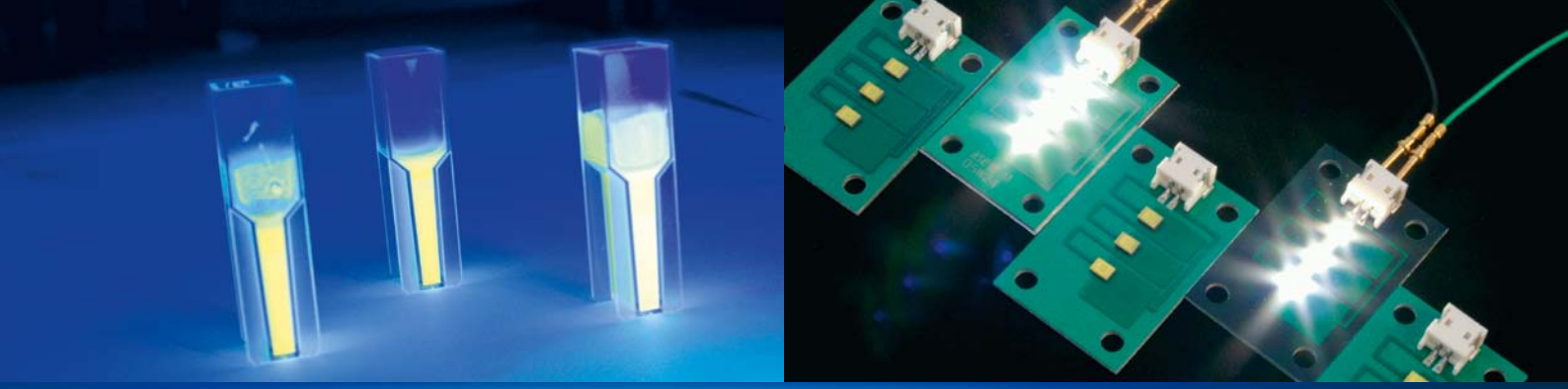
Moderation: U. H. P. Fischer-Hirchert, University of Applied Sciences Harz, Wernigerode

13.30-13.40	Einführung U. H. P. Fischer-Hirchert, University of Applied Sciences Harz, Wernigerode
13.40-14.00	3.1 Silizium-Nanophotonik und Photonisches Wire-Bonding: Technologien für Terabit-Interconnects C. Koos, Institut für Photonik Quantenelektronik des KIT
14.00-14.20	3.2 Polymeroptische Mikroringresonatoren für biosensorische Anwendungen R. Landgraf, Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems
14.20-14.40	3.3 Forschung über CMOS-kompatible Lichtemitter für die integrierte Si-Photonik M. Kittler, Joint lab IHP / BTU Cottbus
14.40-15.00	3.4 Merging Plasmonics and Silicon Photonics Technology towards Tb/s routing in optical interconnects (in englischer Sprache) T. Tekin, Technische Universität Berlin
15.00-15.20	3.5 Integration von Siliziumphotonik durch hochpräzise Aufbau- und Verbindungstechnik H. Schröder, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin
15.20-15.30	Zusammenfassung und Abschlussworte Chair ITG 5.4.1 Andreas Umbach
15.30-16.00	Kaffeepause

SESSION 4: PHOTONIC PACKAGING

Moderation: K.-D. Lang; Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin

16.00-16.10	Einführung K.-D. Lang, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin
16.10-16.30	4.1 Prototype Packaging of Components with 100 GHz RF and Optical Connections (in deutscher Sprache) Ö. Karpuzi, Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, Berlin
16.30-16.50	4.2 Development and packaging of organic microdisplay on 200mm wafer (in englischer Sprache) Ch. Schmidt, K. Fehse, B. Richter, R. Herold, U. Vogel, Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS, Institutsteil Center for Organic Materials and Electronic Devices Dresden (COMEDD), Dresden
16.50-17.10	4.3 Optical Transceiver on Polymer Integration Platform (in englischer Sprache) Z. Zhang, D. de Felipe Mesquida, W. Brinker, J. Wang, C. Zawadzki, N. Keil, N. Grote, Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, Berlin
17.10-17.30	4.4 Dielektrische Elastomer Aktoren für die photonische Systemintegration M. Heimann, H. Schröder, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin G. Kofod, R. Waché, Universität Potsdam B. Kussmaul, Björn, H. Krüger, Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, Potsdam
17.30-17.50	4.5 Integration of large sub-modules to an opto-electronic array R. Schachler, AEMtec GmbH, Berlin
17.50-20.00	Get-together



Kongressprogramm



microsys berlin
Mikrooptik und Mikrooptische Systeme

Mittwoch, 21. März 2012

SESSION 5: LED AND SYSTEM INTEGRATION

Moderation: M. Kneissl; Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin

10.00-10.10	Einführung M. Kneissl, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin
10.10-10.30	5.1 Waferbasierte Montage von mikrooptischen Modulen in der Volumenproduktion J. Kubelka, ArgoTech a.s., Trutnov J-R. Kropp, InBeCon GmbH, Berlin
10.30-10.50	5.2 Entwicklung eines integrierten Kamerasystems mit algorithmisch implementierter Linse R. Utz, L. van Hemmen, Technische Universität München, Physik Department, Garching A. Hilgarth, E. Jung, K-D. Lang, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin
10.50-11.10	5.3 Entwicklungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik für Hochleistungs-LEDs R. Jordan, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin
11.10-11.30	5.4 Gestaltung, Auslegung und Charakterisierung von UV-LED-Strahlungsquellen mit Primäroptik N. Morgenbrod, OSRAM P. Rotsch, R. Schubert, S. Herold, H.Zeng, OSA Opto Light GmbH, Berlin R. Zhytnytska, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin
11.30-11.50	5.5 Effizienzoptimierung und Chipdesign von UV-A- und UV-B-LEDs S. Einfeldt, A. Knauer, V. Kueller, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin N. Lobo, T. Kolbe, J. Stellmach, Institute of Solid State Physics, Technische Universität Berlin, Berlin
11.50-12.30	Kaffeepause

SESSION 6: OPTICAL METROLOGY

Moderation: D. Oberschmidt; Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Berlin





12.30-12.40	Einführung D. Oberschmidt, Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Berlin
12.40-13.00	6.1 Formmessung spiegelnder Freiformen in Ultrapräzisionsmaschinen mittels phasenmessender Deflektometrie E. Uhlmann, M. Kurz, Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb, Technische Universität Berlin G. Häusler, C. Faber, E. Olesch, C. Röttinger, Institut für Optik, Information und Photonik (IOIP), Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen
13.00-13.20	6.2 Miniaturisiertes SPR Sensorsystem für die point-of-care diagnostische Analytik E. Uhlmann, C. Hein, L. David, Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb, Technische Universität Berlin D. Oberschmidt, A. Spielvogel, Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Berlin J. Langbein, Institut für Biotechnologie, Technische Universität Berlin
13.20-13.40	6.3 Fertigungsintegrierte Messtechnik für hybride Leistungsbündel der Mikroproduktion E. Uhlmann, C. Gabriel, C. Stelzer, Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb, Technische Universität Berlin
13.40-14.00	6.4 Kalibrierstrahler des MERTIS Spektrometer / Radiometer aus der ESA Mission BepiColombo zur Erforschung des Planeten Merkur G. Wahnschaffe, Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH, Berlin
14.00	Ende des Kongresses

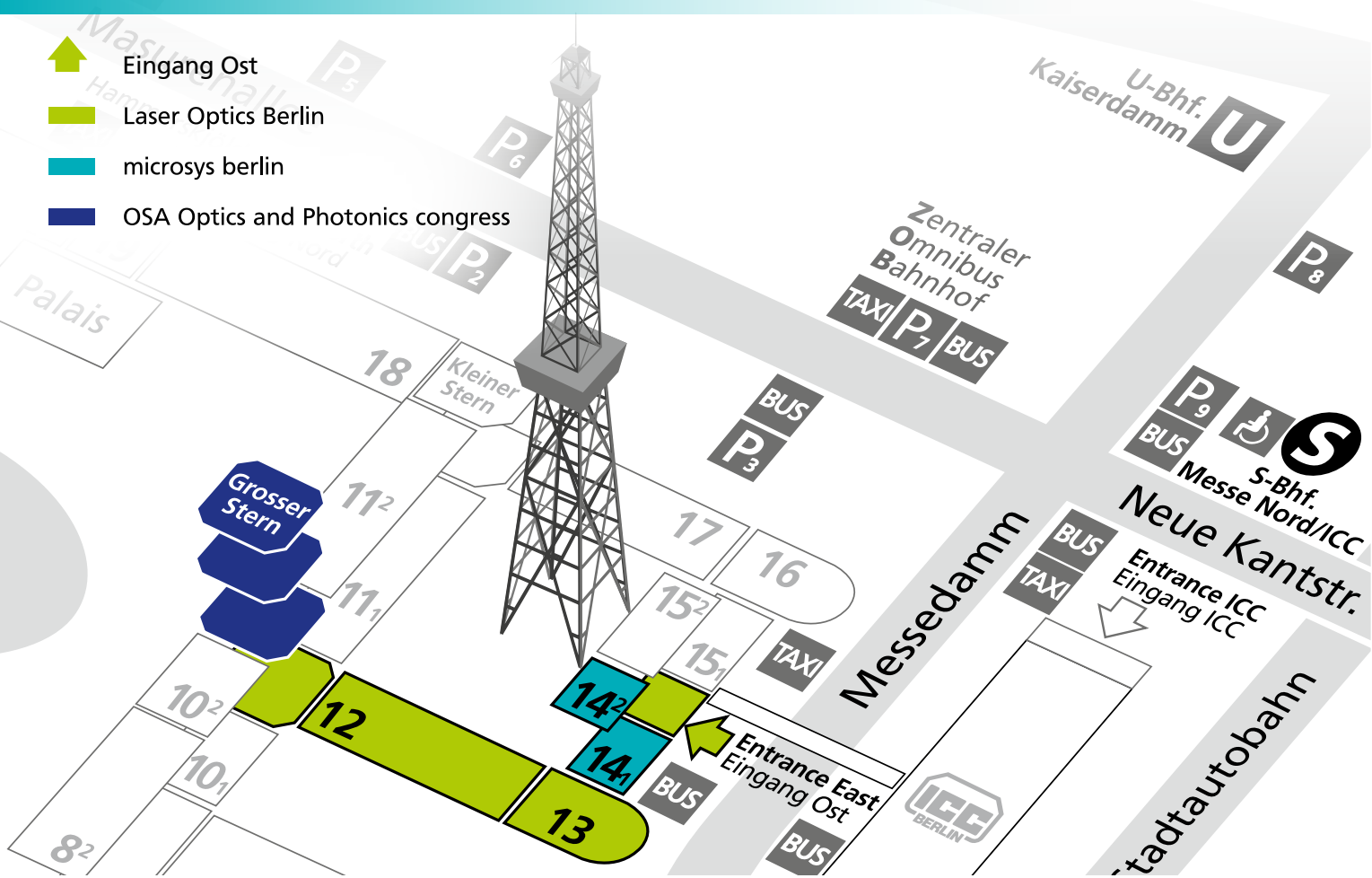


Daten und Fakten



microsyst berlin
Mikrooptik und Mikrooptische Systeme

-  Eingang Ost
-  Laser Optics Berlin
-  microsyst berlin
-  OSA Optics and Photonics congress



Veranstaltungsort

Halle 14.2, Eingang Ost

Veranstalter

TSB Innovationsagentur Berlin GmbH

Co-Veranstalter

Messe Berlin GmbH

Messen

Laser Optics Berlin + microsyst berlin

19.–20. März 2012, 10–17 Uhr

21. März 2012, 10–16 Uhr

Tageskarte 16 €, ermäßigt 5 €*
Dauerkarte 23 €, ermäßigt 11€*

Kongress

microsyst berlin Kongress**

20.–21. März 2012

Tageskarte 100 €, ermäßigt 20 €*
Dauerkarte 180 €, ermäßigt 30 €*
* ermäßigt für Schüler und Studenten
** alle Kongresstickets inkl. Messe

Tickets und Registrierung

im Online-Ticketshop unter:

www.laser-optics-berlin.de

Kongresssprache ist deutsch mit
englischer Simultanübersetzung.

* ermäßigt für Schüler und Studenten

** alle Kongresstickets inkl. Messe

www.laser-optics-berlin.de